

## 2025年度 (2026年3月期) 第1四半期決算説明会

2025/08/04

株式会社東京精密

代表取締役社長CEO

木村 龍一

執行役員常務 CFO

小泉 公人

経営支援室 IRチームリーダー

高嶋 直樹

- ・ **将来の事象に係わる記述に関する注意**：本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- ・ **用語について**：注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- ・ **記入データについて**：記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- ・ **監査について**：本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

## 2025年度 第1四半期 連結業績

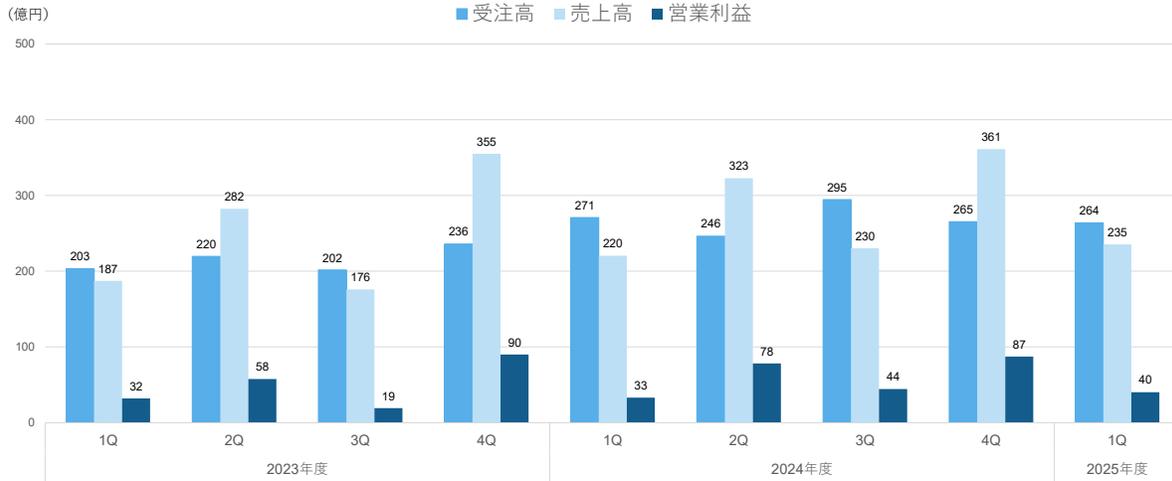
第1四半期の売上高・受注高は、概ね前年同期並み、営業利益は増益で着地

全社業績(億円)		2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	2025-1Q	前四半期比	前年同期比
受注高		374	337	392	353	359	+2%	-4%
売上高		296	418	317	474	309	-35%	+4%
営業利益		41	93	57	106	46	-57%	+12%
(利益率)		(14%)	(22%)	(18%)	(22%)	(15%)	-8pt	+1pt
経常利益		43	88	66	101	45	-56%	+3%
当期純利益		36	100	46	75	32	-57%	-9%
研究開発費		23	28	25	28	25	-10%	+9%
設備投資		28	12	24	39	25	-35%	-10%
減価償却費		12	13	13	13	12	-8%	+2%
セグメント別業績		2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	2025-1Q	前四半期比	前年同期比
半導体 製造装置	受注高	271	246	295	265	264	-1%	-3%
	売上高	220	323	230	361	235	-35%	+7%
	営業利益	33	78	44	87	40	-54%	+22%
	(利益率)	(15%)	(24%)	(19%)	(24%)	(17%)	-7pt	+2pt
計測機器	受注高	103	91	98	87	95	+9%	-8%
	売上高	76	95	87	113	73	-35%	-3%
	営業利益	8	15	12	19	5	-71%	-28%
	(利益率)	(10%)	(16%)	(14%)	(17%)	(7%)	-9pt	-3pt

- 代表取締役社長CEOの木村です。  
本日はご多忙のところ、ご参加いただきまして 厚く御礼申し上げます。
- それでは、決算概要を説明いたします。  
まず、2ページ目の上段、第1四半期の全社業績は、  
受注高359億円、売上高309億円、営業利益46億円、経常利益45億円、  
営業利益率は15%となり、いずれも前年同期比で増加しました。  
なお、法人税等調整額が増加したことにより、親会社株主に帰属する  
当期純利益は、前年同期比で減益となりました。
- 売上高の前年同期比での増加は、主に半導体の売上が増加したことによります。  
営業利益の増加もこれによるものです。
- 受注高は、両セグメントとも、概ね想定並みの着地となりました。
- 次に、セグメント別に説明いたします。

## 半導体製造装置セグメント 業績推移

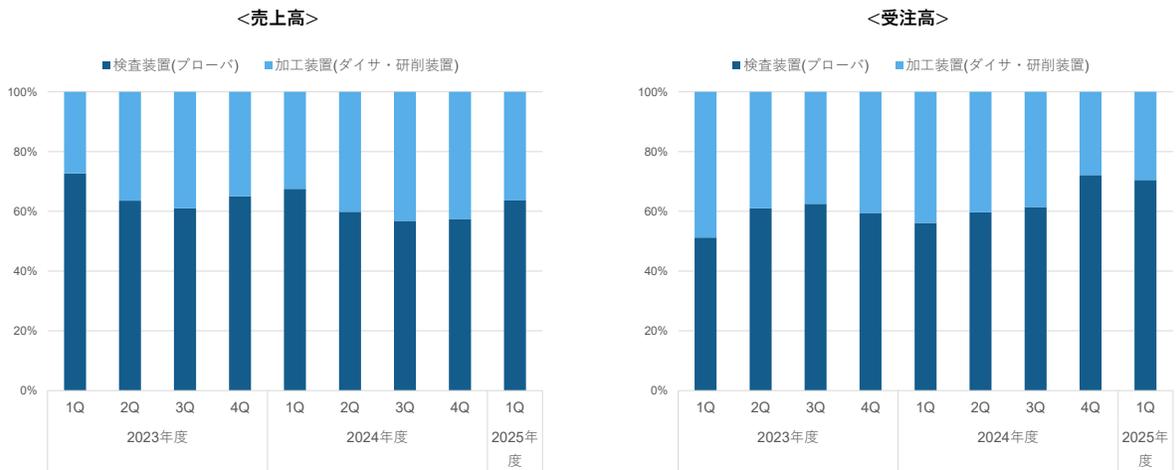
第1四半期の受注高は、引き続き生成AIを含むHPC需要ならびに中国需要がけん引  
(第2四半期の受注高見込は11ページに記載)



- 3ページは、半導体の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。
- この第1四半期の受注高は264億円で、前年同期、ならびに前年第4四半期と同水準、社内想定に対しても同水準の着地でした。  
前年から引き続き、生成AIを含むHPC関連、ならびに中国需要がけん引しています。
- なお、第2四半期の受注高の見込みは、後ほど説明いたします。
- 第1四半期の売上高は、概ね顧客の要求納期に沿った出荷を進めたことで、想定並みの着地でした。

## 半導体製造装置セグメント 製品別構成比

プローバの受注構成比が高い傾向が続く



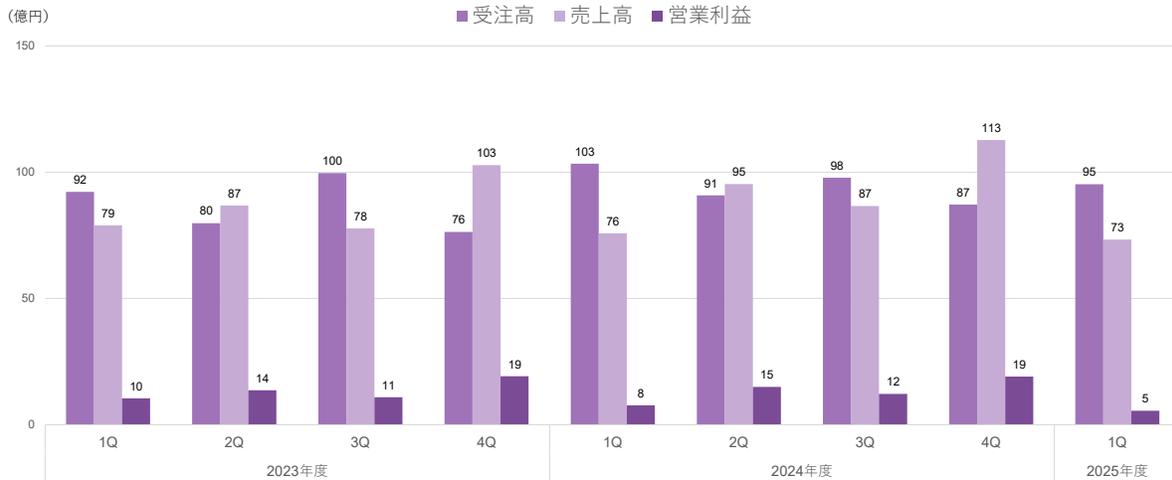
4 @ TOKYO SEIMITSU

ACCRETECH | 東京精密

- 4ページは、半導体の四半期受注高・売上高を装置別に示したものです。
- 右側、受注高について、第1四半期の検査装置、プローバの受注構成比は7割程度となりました。
- これは、HPCなどのハイエンドデバイスの検査需要が、引き続き堅調に推移していることによります。

## 計測機器セグメント 業績推移

第1四半期の受注高は、更新投資や航空宇宙・自動化向け等の新規需要獲得に努め、想定並みの着地  
(第2四半期の受注高見込は12ページに記載)



- 5ページは、計測の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。
- 第1四半期の受注高は95億円で、想定並みの着地となりました。
- 関税政策の影響により、自動車や機械分野の新規需要は軟調でしたが、更新需要や、ものづくりの自動化に向けた需要、航空宇宙・防衛分野などの業界での新規需要の獲得に努めました。
- なお、第2四半期の受注高の見込みは、後ほど説明いたします。

## 計測機器セグメント 製品別構成比

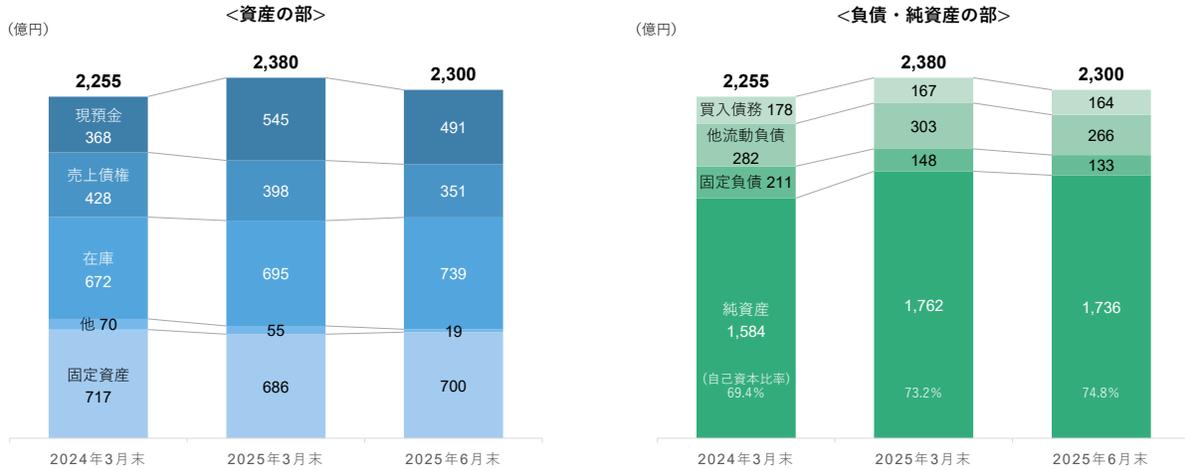
第1四半期は受注・売上ともに大きな変化はない



- 6ページは、計測の四半期受注高・売上高を装置別に示したものです。
- 製品別動向に大きな変化はございません。

## 貸借対照表

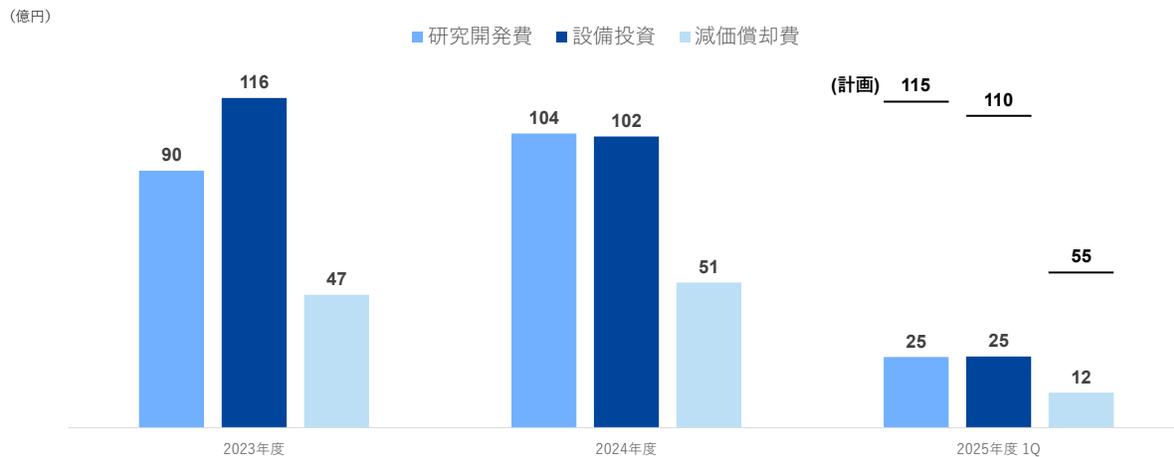
現預金・売上債権が減少、在庫が増加



- 7ページは貸借対照表の説明です。
- 2025年6月末の総資産は、2,300億円となりました。
- 左側、資産の部ですが、  
現預金は、配当金や法人税の支払いなどにより減少したほか  
売掛金も回収が進んだことにより減少しています。  
第2四半期の売上高が増加する想定であることから、  
在庫は増加しています。
- 右側、負債・純資産の部については、  
借入金の返済などにより、負債が減少しました。
- 6月末の自己資本比率は74.8%となりました。

## 研究開発費・設備投資・減価償却費

第1四半期は八王子新工場の着工に向けた設備投資が発生



- 8ページは研究開発費、設備投資、減価償却費の実績です。
- 棒グラフが第1四半期の実績、横線が通期計画を示しています。実績はご覧の通りで、通期計画の変更はございません。なお、この第1四半期は、八王子新工場の着工に向け、用地の取得費用が発生しています。
- ここまでが、2025年度第1四半期の実績の説明となります。

## 2025年度通期業績予想の前提(青字:8月変更)

### 売上・営業利益

関税政策の影響：計測中心に軽微な納入後ずれ傾向が見られるが、業績予想への影響はない

半導体：引き続き生成AIを含むHPC案件の売上が貢献

- 生成AIを含むHPC：売上高・利益に占める割合は増加(3割程度)
- グローバルOSAT：HPC向けブローバの出荷増加を想定
- 中国需要：受注済案件の出荷・据付が計画通り続く

計測：高水準を維持、下期以降は充放電試験システムの売上が貢献

利益：部材調達価格・経費等の上昇が見込まれるが、原価低減活動を進める

### 受注動向

関税政策の影響：両セグメントとも、短期的な投資判断の後ずれ傾向が見られる

半導体：下期偏重との見方に変更

- 生成AIを含むHPC：HBM向けで期初想定よりも下期偏重を見込む
- グローバルOSAT：稼働率は回復傾向。China +1 需要を含む投資拡大に期待
- 中国需要：HPC向けが全般に堅調

計測：引き続き、更新投資や充放電試験システムの事業機会を捉える

- 9ページには、2025年度の通期業績予想の前提を示しております。青字が、期初、5月の説明からの変更点です。
- 上段の、売上・利益の前提ですが、計測を中心に納入の後ずれ傾向が見られますが、その他の見方に変更はなく、業績予想を変更するほどの影響は想定しておりません。引き続き、半導体の、生成AIを含むHPC向け売上が貢献するものと想定しています。
- 下段の、受注の前提はご覧の通り変更しています。まず、関税政策の影響により、投資判断に1、2か月の後ずれ傾向が見られます。さらに、HBM需要ですが、顧客の投資動向を勘案すると、期初に想定していた以上に、下期に受注が偏重する可能性が考えられます。このため、第2四半期の受注高の見込みを変更しています。

## 2025年度通期業績予想

2025年5月9日に公表した通期業績予想・配当予想を据え置き

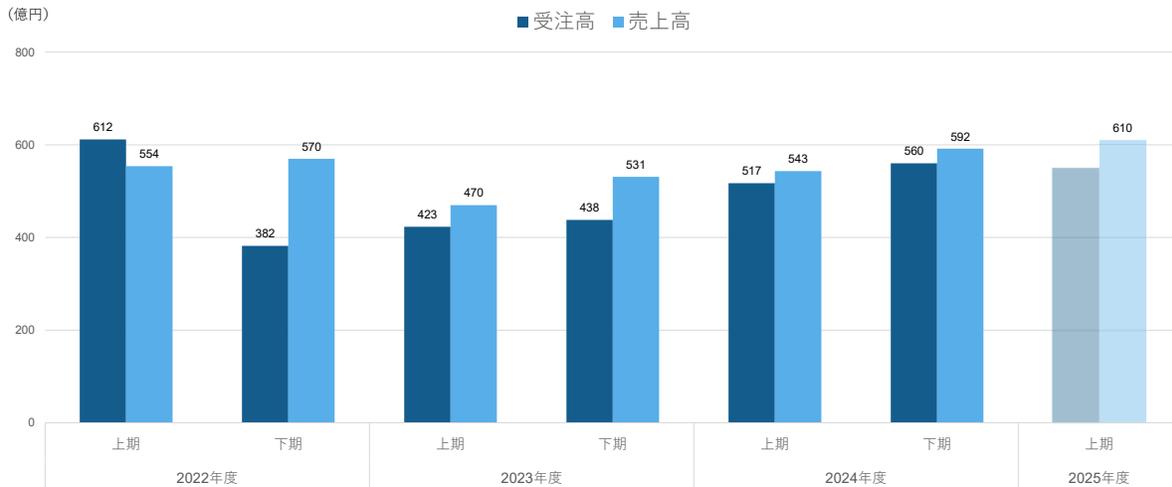
半導体は、引き続き生成AIを含むHPCがけん引、計測は、事業環境に大きな変化はない想定  
前提為替レートは140円/ドル（為替変動影響は軽微：円建て比率高）

全社業績(億円)	2024年度 上期	2024年度 下期	2024年度通期	2025年度 上期予	2025年度 下期予	2025年度通期予	前期比
受注高	711	745	1,456	-	-	-	-
売上高	714	791	1,505	785	805	1,590	+6%
営業利益	134	163	297	152	158	310	+4%
(利益率)	(19%)	(21%)	(20%)	(19%)	(20%)	(20%)	-0pt
経常利益	132	168	299	152	158	310	+4%
当期純利益	136	121	256	106	111	217	-15%
研究開発費	51	53	104	-	-	115	+11%
設備投資	40	63	102	-	-	110	+7%
減価償却費	25	26	51	-	-	55	+8%
セグメント売上高	2024年度 上期	2024年度 下期	2024年度通期	2025年度 上期予	2025年度 下期予	2025年度通期予	前期比
半導体製造装置	543	592	1,135	610	610	1,220	+8%
計測機器	171	199	371	175	195	370	-0%

- 10ページは、これらの前提を踏まえた2025年度の通期業績予想です。  
売上・利益については、5月に開示した業績予想に変更ございません。
- この第2四半期は、第1四半期に対して売上・利益ともに増加する想定です。
- 前提為替レートも変更なく、1ドルが140円を据え置いております。  
現時点では、為替変動による業績への変動は軽微と見積もっております。

## 半導体製造装置セグメント- 売上・受注高 半期見込

HBM需要が2025年度下期偏重になる見込みより、上期受注高は前年下期比で10%増 → 同 微減の見方に変更  
(第2四半期は第1四半期比 約10%増を想定)



- 11ページは、半導体事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 25年度上期の受注高の見通しですが、  
期初予想、すなわち前年下期比10%程度増加の予想から、  
ご覧の形へ変更しています。  
先ほど申し上げたように、上期に見込んでいたHBM案件を中心に、  
下期偏重になる可能性を想定したものです。
- なお、この結果、第2四半期の受注高の想定は、  
第1四半期比で約10%の増加を想定しています。

## 計測機器セグメント – 売上・受注高 半期見込

上期受注高に変更はなく、前年下期比で微増を想定  
(第2四半期は第1四半期比 微増を想定)



- 12ページは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 5月の説明から、見通しに変更はありません。
- 第2四半期の受注高の見込は第1四半期比で微増を想定しています。
- 以上が、2025年度第1四半期決算の説明となります。  
ご清聴 ありがとうございました。

## 質疑応答 / Q&A

## Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Oxides 酸化膜	半導体 SPE	152,896	99,366	86,082	107,713	27,081	24,631	29,456	26,544	26,378			
	計測 Metr.	33,159	36,960	34,802	37,917	10,336	9,082	9,781	8,717	9,523			
	合計 Total	186,056	136,326	120,885	145,631	37,417	33,713	39,237	35,262	35,901			
Backlog 受注残高	半導体 SPE	102,370	89,371	75,398	69,630	80,433	72,785	79,205	69,630	72,466			
	計測 Metr.	9,904	12,428	12,606	13,470	15,362	14,911	16,031	13,470	15,660			
	合計 Total	112,274	101,799	88,004	83,101	95,796	87,697	95,236	83,101	88,127			
Sales 売上	半導体 SPE	101,145	112,365	100,055	113,481	22,046	32,280	23,036	36,118	23,542			
	計測 Metr.	29,556	34,436	34,624	37,053	7,580	9,532	8,661	11,278	7,333			
	合計 Total	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876			
OP 設備売却	半導体 SPE	24,698	29,866	19,899	24,311	3,314	7,824	4,449	8,722	4,031			
	計測 Metr.	3,628	4,628	5,408	5,392	768	1,497	1,220	1,905	549			
	合計 Total	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581			
Op Margin 設備売却前	半導体 SPE	24.4%	26.6%	19.9%	21.4%	15.0%	24.2%	19.3%	24.1%	17.1%			
	計測 Metr.	12.3%	13.4%	15.6%	14.6%	10.1%	15.7%	14.1%	16.9%	7.5%			
	合計 Total	21.7%	23.5%	18.8%	19.7%	13.8%	22.3%	17.9%	22.4%	14.8%			

## Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
売上高 Net Sales	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876				
売上原価 Cost of goods sold	77,694	84,967	79,917	88,081	17,753	24,757	17,960	27,609	18,468				
売上総利益 Gross Profit on Sales	53,008	61,834	54,762	62,453	11,873	17,054	13,738	19,787	12,407				
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,681	27,339	29,454	32,750	7,790	7,732	8,067	9,159	7,825				
営業利益 Operating profit	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581				
営業外収益 Non-operating income	987	965	1,404	921	287	39	539	55	133				
営業外費用 Non-operating expenses	153	162	259	684	41	531	-422	534	252				
経常利益 Recurring Profit	29,160	35,297	26,453	29,939	4,329	8,829	6,632	10,148	4,462				
特別利益 Extraordinary gains	390	103	824	4,493	10	4,483	0	0	3				
特別損失 Extraordinary losses	34	2,099	21	158	-	-	157	0	-				
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	29,516	33,301	27,255	34,275	4,339	13,312	6,474	10,148	4,465				
法人税等合計 Total Income tax and others	8,132	9,607	7,791	8,531	754	3,310	1,870	2,596	1,228				
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	57	62	84	106	31	6	29	39	7				
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	21,326	23,630	19,378	25,637	3,554	9,996	4,574	7,512	3,229				
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	522.52	581.33	480.49	633.75	87.89	247.09	113.07	185.67	79.77				
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	517.51	575.62	475.42	628.31	-	-	-	-	-				

## Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円) (Million Yen)		2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(1Q末) FY2026/3(1Q)
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	40,080	36,782	54,541	49,147
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	43,403	42,801	39,809	35,088
	在庫 Inventories	53,482	67,225	69,513	73,858
	その他 Others	7,005	7,022	5,477	1,917
	合計 Total	143,972	153,831	169,341	160,013
固定資産合計 Total Fixed Assets	65,060	71,693	68,610	69,969	
総資産 Total Assets	209,032	225,524	237,952	229,982	
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	22,359	17,845	16,665	16,448
	その他 Others	28,588	28,156	30,268	26,648
	合計 Total	50,947	46,002	46,933	43,097
固定負債合計 Total long-term liabilities	12,057	21,094	14,789	13,254	
負債合計 Total Liabilities	63,004	67,097	61,723	56,351	
純資産合計 Total Net Assets	146,028	158,427	176,229	173,630	
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets	209,032	225,524	237,952	229,982	
有利子負債合計 Total interest-bearing debt	14,191	25,171	20,084	18,327	
自己資本比率 Equity Ratio(%)	69.0%	69.4%	73.2%	74.8%	
自己資本利益率 ROE(%)	17.3%	12.9%	15.5%	-	

※1: 電子記録債権、契約資産を含む  
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む  
Incl. Electronically recorded obligations-operating

## Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(1Q末) FY2026/3(1Q)
研究開発費 R&D expenses	8,542	9,042	10,354	2,488
設備投資 Capex	9,725	11,602	10,245	2,504
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,832	4,673	5,105	1,230

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	1,000	4,892	28,824
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,421	-10,563	2,541
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-7,421	-5,671	31,365
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-2,174	1,616	-13,991
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	625	755	404
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	40,036	36,736	54,516

(人数) (# of People)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期(1Q末) FY2026/3(1Q)
正社員合計 Total regular employees	2,468	2,658	2,767	2,884
臨時従業員 年間平均雇用人員数 (※1) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,258	1,225	1,258	1,291
従業員合計 (※1) Number of employees	3,726	3,883	4,025	4,175

17

@ TOKYO SEIMITSU

※1: 従前の補足資料では、臨時従業員数の期末の実数を表記しておりましたが、年間平均数に改めております。また従業員合計は、正社員合計人数と、期間平均臨時従業員数の単純合算です。  
In previous supplementary documents the number of temporary employees was given as the actual number at the end of each fiscal term. However, this has been revised to the average number for each period. Therefore, "Number of employees" is a simple sum of the total number of regular employees and the average number of temporary employees during the period.

ACCURETECH | 東京精密